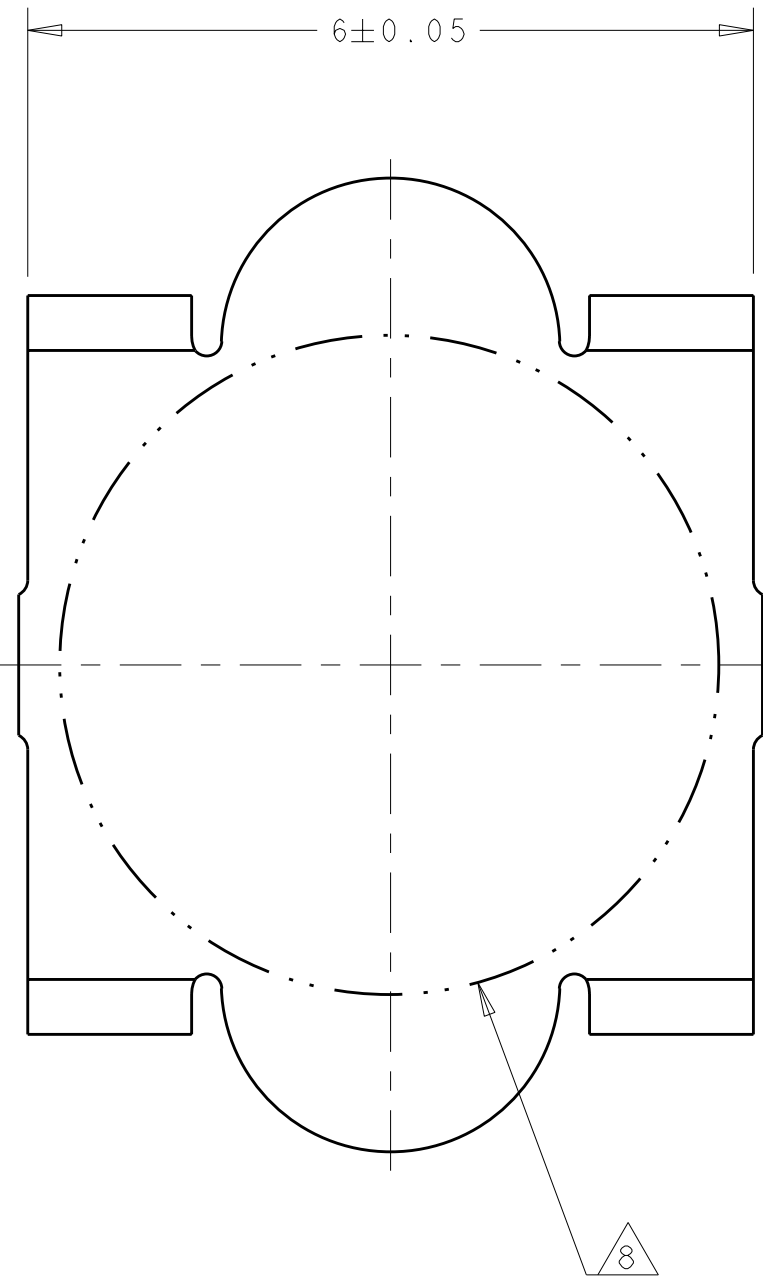
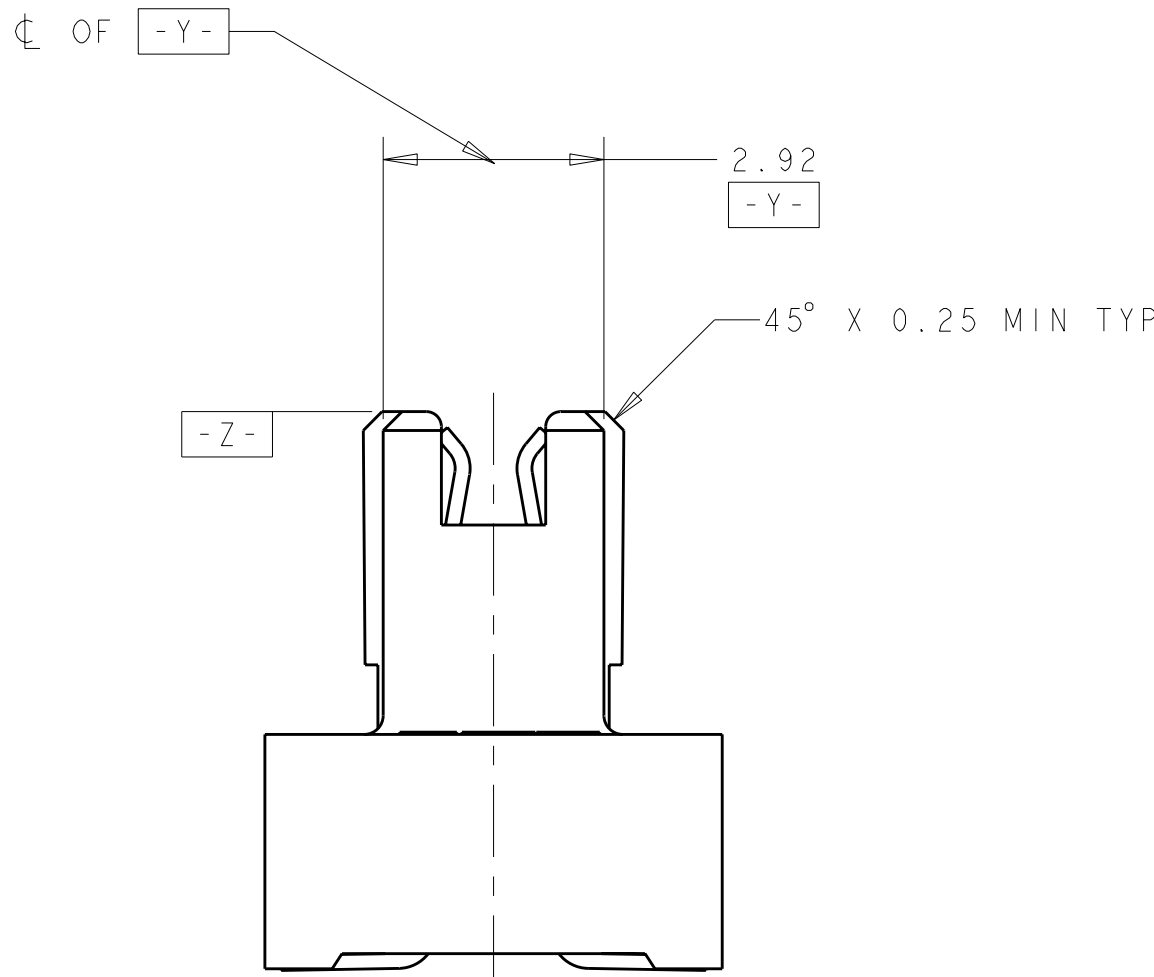
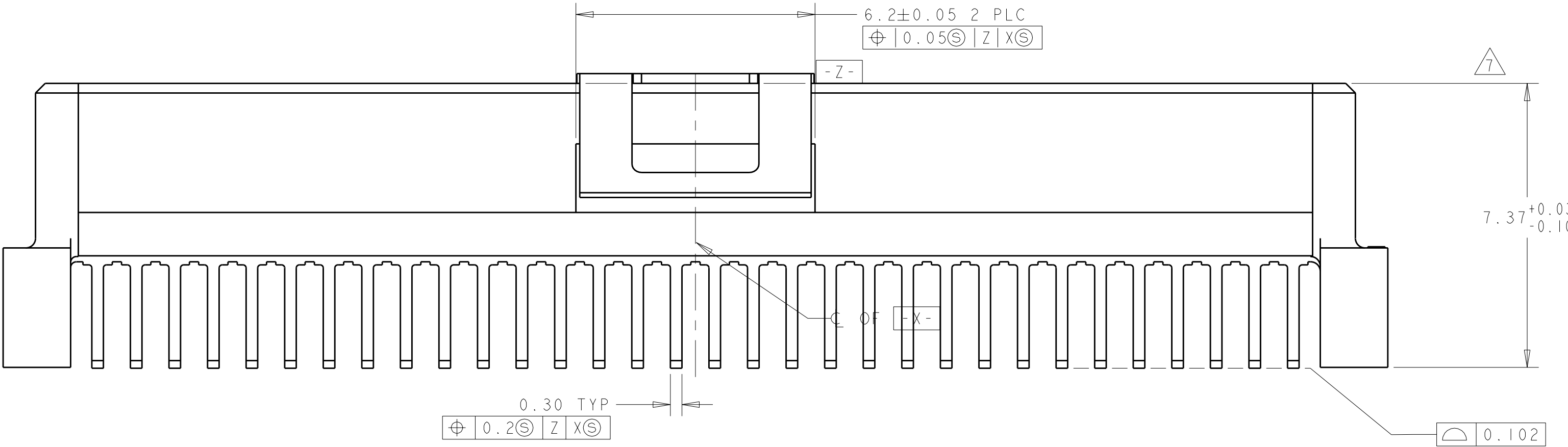
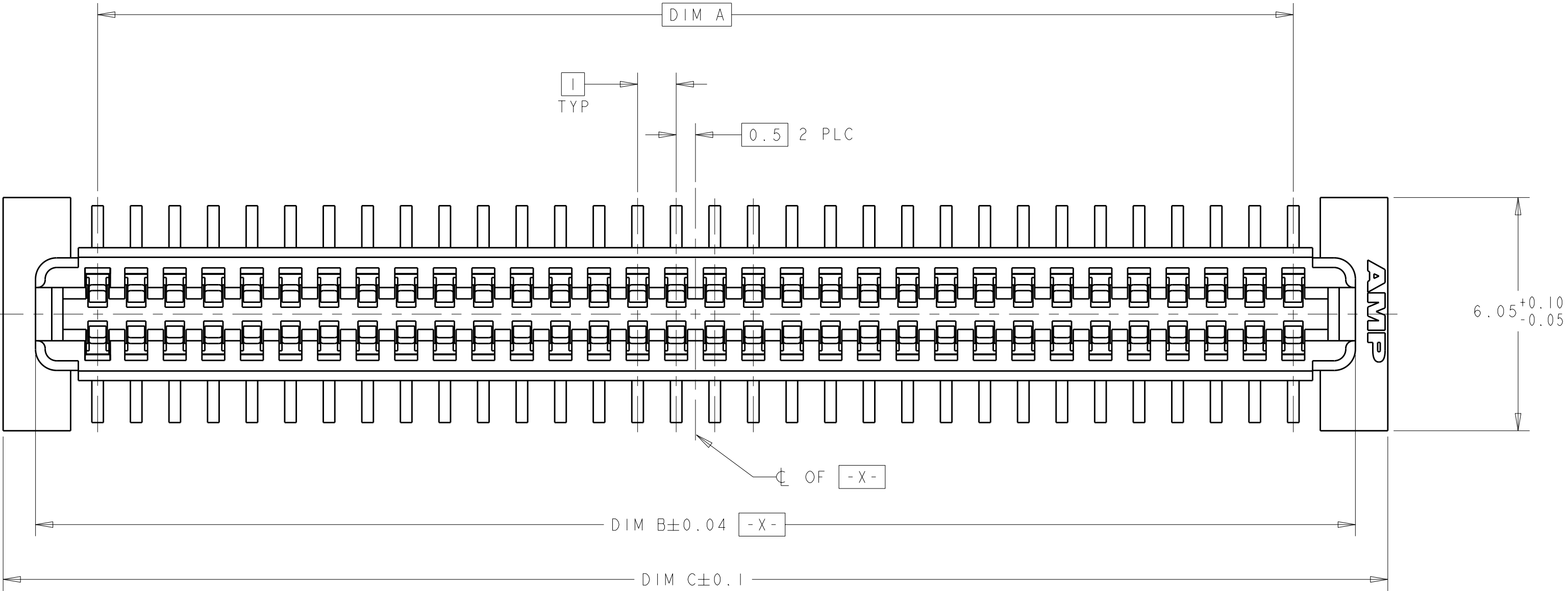
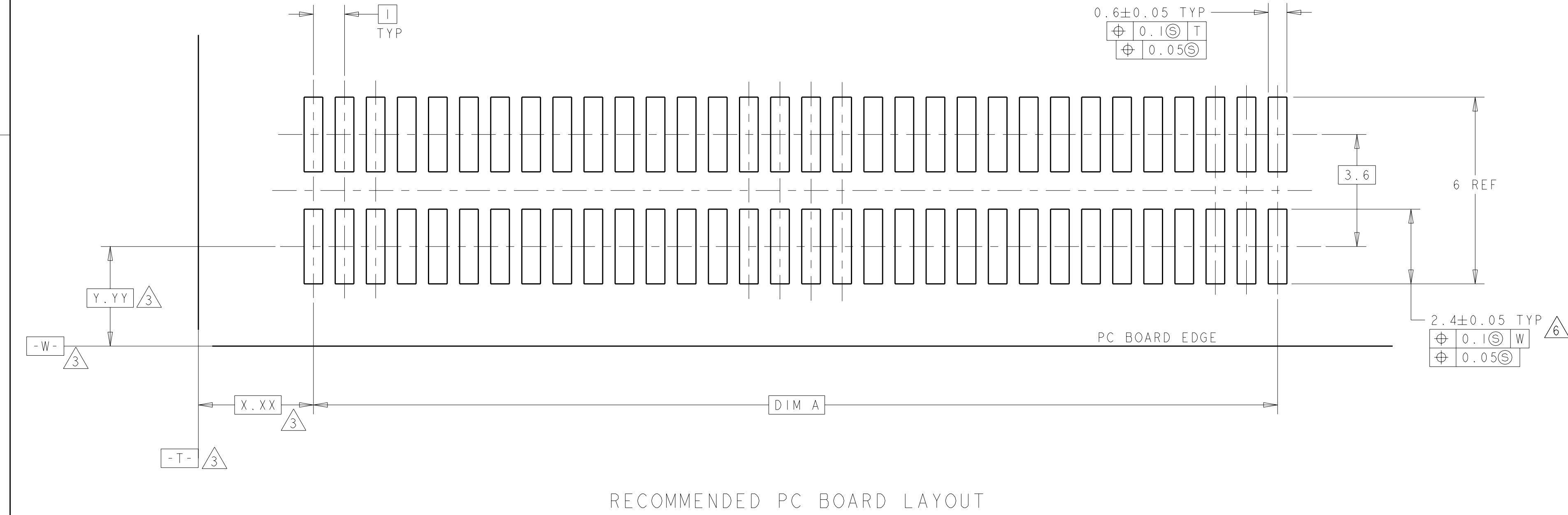


LOC	DIST	REVISIONS			
		REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
AD	00	0	REV PER EC 0512-0235-04	30SEP2004	BC RW
		A	REVISED PER ECO-08-008615	10JUL2008	DH DB

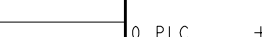


VACUUM COVER



- 1. HOUSING MATERIAL: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC, COLOR: BLACK
- 2. CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE
- 3. CONTACT FINISH: NICKEL UNDERPLATE ALL OVER, MATING SURFACES PLATED TO MEET PLI PERFORMANCE REQUIREMENTS OF INDUSTRY SPECIFICATION EIA-700AAAB, SOLDER TAILS PLATED TIN.
- 4. DATUM LOCATIONS AND BASIC DIMENSIONS TO BE ESTABLISHED BY THE CUSTOMER. CONSULT AMP ENGINEERING WHEN PLACING MULTIPLE CONNECTORS ON A PC BOARD.
- 5. PACKAGED IN TAPE ON REEL PER EIA-481.
- 6. VACUUM COVER DESIGNED FOR 4mm DIA. NOZZLE. COVER TO BE REMOVED AFTER SOLDERING. VACUUM COVER OMITTED FROM SOME VIEWS FOR DIMENSIONAL CLARITY.
- 7. SHORTER SOLDER LANDS MAY BE USED PER EIA 700AAAB, HOWEVER 2.4 LENGTH ASSURES OPTIMUM SOLDER FILLET REGARDLESS OF MANUFACTURER OF CONNECTOR.
- 8. REFERRED TO AS DIM H = 7.30 ± 0.1 IN EIA 700AAAB SPECIFICATION.
- 9. 5.5 MIN DIA TARGET AREA FOR VACUUM PICK-UP.
- 10. CONTACT FINISH: 0.00381 MINIMUM MATTE TIN PER ASTM B 545 ON SOLDER AREA, 0.00127 MINIMUM GOLD PER ASTM B 488 ON MATING AREA, BOTH OVER 0.00127 MINIMUM NICKEL PER SAE-AMS-QQ-N-290 ON ENTIRE CONTACT.

9	45.9	44.22	41	5120534-2	12	84	1-5120529-2
9	45.9	44.22	41	5120533-2	11	84	1-5120529-2
9	35.9	34.22	31	5120534-1	12	64	1-5120529-1
9	35.9	34.22	31	5120533-1	11	64	1-5120529-1
2	45.9	44.22	41	5120534-2	12	84	5120529-2
2	45.9	44.22	41	5120533-2	11	84	5120529-2
2	35.9	34.22	31	5120534-1	12	64	5120529-1
2	35.9	34.22	31	5120533-1	11	64	5120529-1
FINISH	DIM C	DIM B	DIM A	MATING CONNECTOR	STACK HGTS	POS	PART NO

TYP. IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE FOR THE FOLLOWING REASONS: 1. CHANGES TO MEET CUSTOMER REQUIREMENTS 2. CHANGES TO MEET INDUSTRY REQUIREMENTS 3. CHANGES TO MEET GOVERNMENT REQUIREMENTS 4. CHANGES TO MEET ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS 5. CHANGES TO MEET SAFETY REQUIREMENTS 6. CHANGES TO MEET LEGAL REQUIREMENTS 7. CHANGES TO MEET TECHNOLOGICAL REQUIREMENTS 8. CHANGES TO MEET MARKET REQUIREMENTS 9. CHANGES TO MEET COMPETITIVE REQUIREMENTS 10. CHANGES TO MEET SUPPLIER REQUIREMENTS 11. CHANGES TO MEET MANUFACTURING REQUIREMENTS 12. CHANGES TO MEET ASSEMBLY REQUIREMENTS 13. CHANGES TO MEET TESTING REQUIREMENTS 14. CHANGES TO MEET PACKAGING REQUIREMENTS 15. CHANGES TO MEET DISTRIBUTION REQUIREMENTS 16. CHANGES TO MEET SUPPORT REQUIREMENTS 17. CHANGES TO MEET TRAINING REQUIREMENTS 18. CHANGES TO MEET DOCUMENTATION REQUIREMENTS 19. CHANGES TO MEET RECORDS REQUIREMENTS 20. CHANGES TO MEET COMPLIANCE REQUIREMENTS		DWN B. CARBO 30SEP04	tyco Electronics		Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: mm		CHK R. WERTZ 30SEP04	30SEP04	NAME		
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC		
		502-1079		RECEPTACLE ASSEMBLY, W/ COVER, 1.0mm FH(IEEE1386) CONNECTOR		
		APPLICATION SPEC		SIZE CAGE CODE DRAWING NO		
		114-25045		A1 00779 C=5120529		
		WEIGHT		RESTRICTED TO		
		-		-		
MATERIAL		CUSTOMER DRAWING		SCALE 10:1 SHEET 1 OF 1 REV A		
		SEE TABLE				

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9